

■ SiP化によりPCBコスト・設計リスクを吸収

課題要素	汎用DDR 外付け		x64 FCRAM SiP	
DRAM コスト	NG (高い)	複数個のメモリが必要	Good (低い)	汎用DDR 2個を FCRAM 1個に置き換え
PCB コスト	NG (高い)	終端抵抗, ノイズフィルタ	Good (低い)	PCB面積と層数を削減
PCB設計 リスク	NG (高い)	EMI, SIによる歩留まり 低下や開発遅延	Good (なし)	試験されたものを搭載

